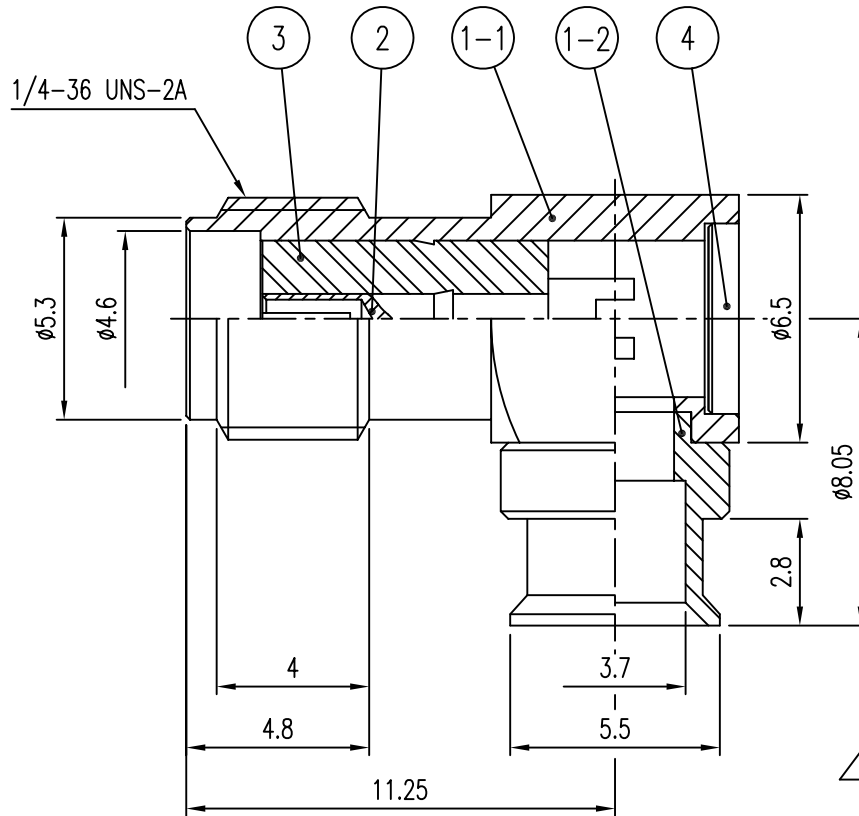


수 정 내 용									
ST	가	장							
부호	내 용						수정자	승인자	년 월 일
1	[설번지리No.201606-0001] Cover 들뜸 및 비정상적으로 연착되는 현상으로 인한 Cover CODE 변경						김찬경	김인철	2016. 06. 09.
2	[설번No.201806-0001] 조립성 개선으로 인한 배디 넘시마는 추가 및 빼이당 표준화						은선영	김인철	2018. 06. 04.



1	4	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00026-5/2 DCO00031 5/4 (L2013)
	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00090-N/1 (H2019)
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00156-5/1 (E2197)
1	1-2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01325-3/1 (D2178B)
	1-1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00229-5/1 DBD00225-3/1 (D2178A)

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2018. 06. 04.					 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
	승인		I. C. KIM						
	검도								
재질	제도		S. Y. EUN			도명 SMA50 CABLE JL 141			
열처리	작성부서 연구 소								
보호피막처리	척도 5/1		단위 mm	중량		A4	도번 CN00128-7/1		
							K314-281-000		